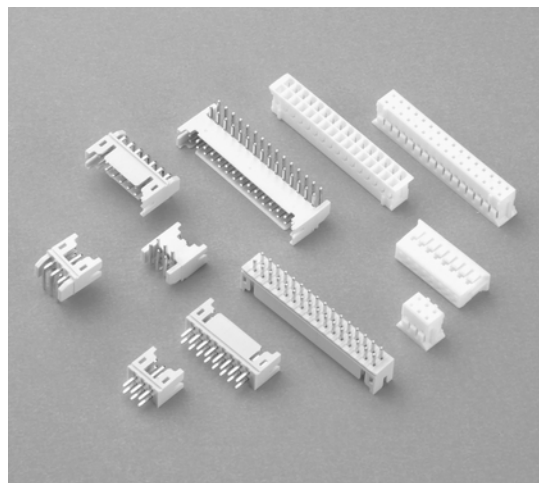


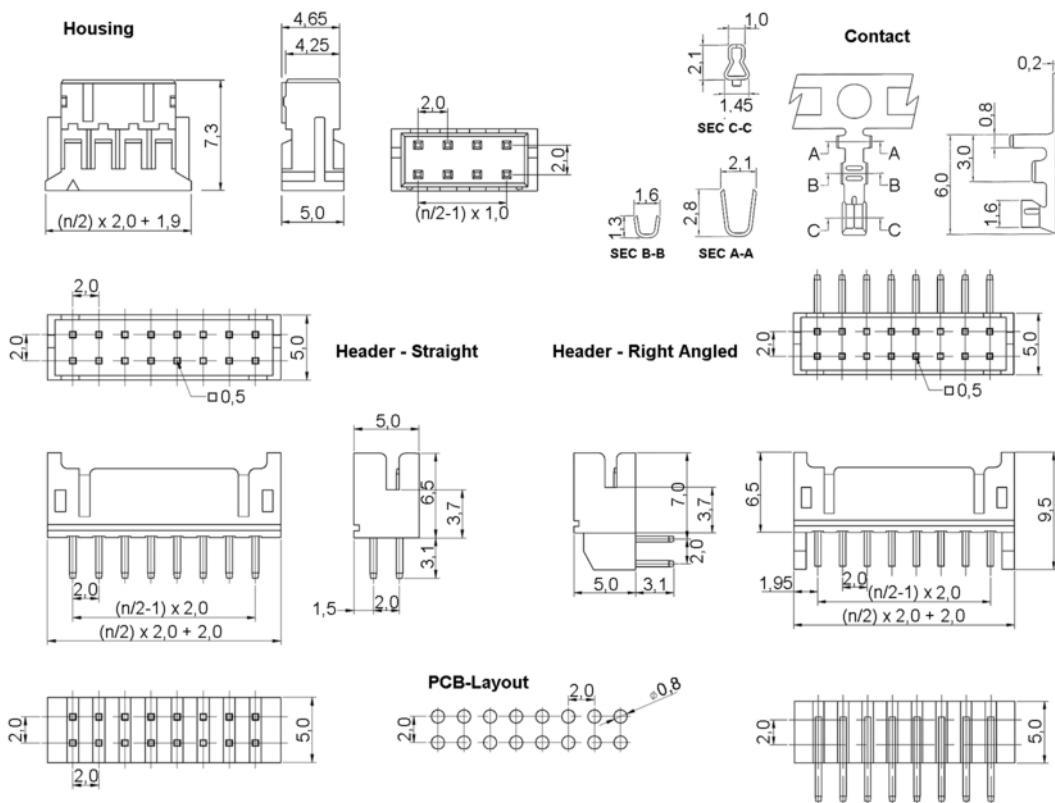
Stift-/Buchsenleisten - Crimp-Rast-System - RM 2,00mm Friction Lock Header and Crimp Housing - Pitch 2,00mm

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Aderquerschnitt	AWG 22 ... 28
Applicable wire Gauge	AWG 22 ... 28
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit	800V _{AC}
Test Voltage	800V _{AC}
Nennspannung	100V _{AC/DC} max.
Voltage Rating	100V _{AC/DC} max.
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Type*	Plating
522	06 06/08/10/12/14/16/18/ 20/22/24/26/28/30/32	3 1 Buchsengehäuse Housing 2 Buchsenkontakte Crimp contacts 3 Stiftleiste gerade Straight pin header 4 Stiftleiste gewinkelt Right angled pin header	50 50 Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich) Tin plated (not necessary for housings)

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Wellenlötverfahren

Wave Soldering Information

Wellenlötverfahren Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.
Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

